

ガスアトマイズ金属粉末

液体急冷金属薄帯

— 製品特徴 —

- ① 高球状性・高純度
- ② 焼結性に優れた微細粒径
- ③ 合金設計の柔軟性



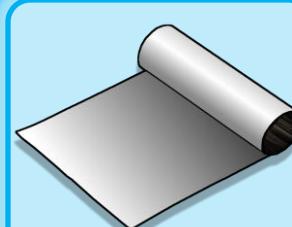
素材：金属粉末



スパッタリングターゲット
▶薄膜の成膜用



高周波電源のトランス
▶半導体製造装置用



材料：金属薄帯

— 製品特徴 —

- ① 高周波領域での低損失特性
- ② 高飽和磁束密度、優れた透磁率
- ③ 優れた温度安定性とノイズ抑制性能

— 半導体関連用途 —

スパッタリングターゲット材：
薄膜形成用 (Al, Cu, Ti 等)

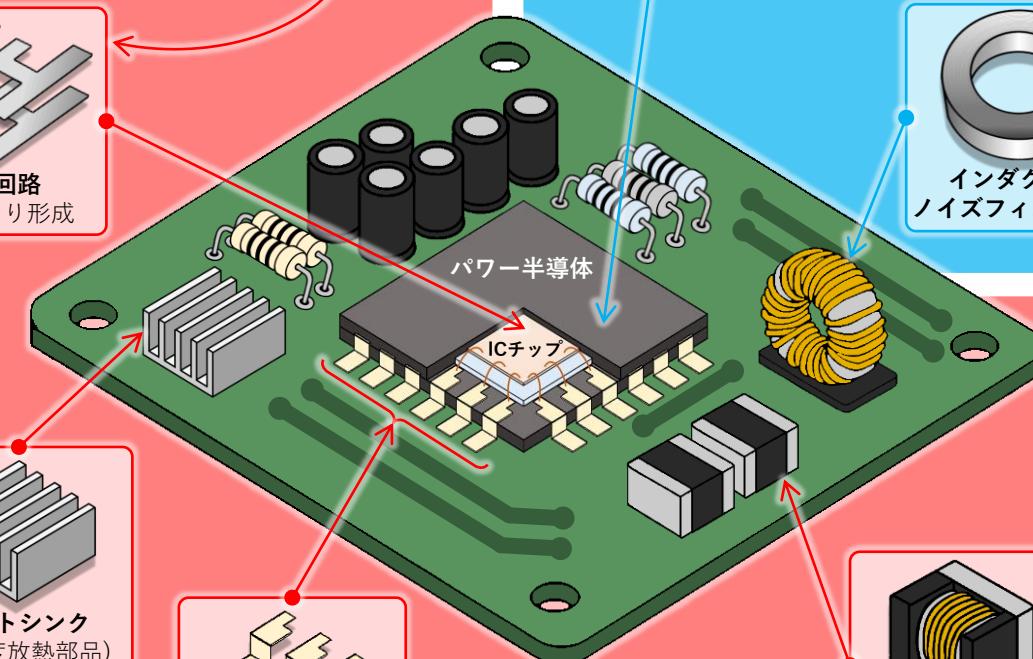
高密度放熱部品材：
パワーデバイスの温度管理に貢献
(W-Cu合金等)

リードフレーム：
導電性接着剤によるICチップとの
接着、機能性向上の表面処理
(メッキ、スパッタリング)

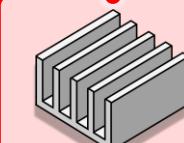
チップインダクタコア：
パワー半導体向け



集積回路
▶薄膜より形成



基板略図



ヒートシンク
(高密度放熱部品)



リードフレーム
▶ICチップとの接着
▶機能性向上の表面処理



チップインダクタコア

— 半導体関連用途 —

製造装置用高周波電源のトランス：
RFエネルギー制御に使用

インダクタ・トランスコア：
パワー半導体向け (SiC/GaN対応)

ノイズフィルタコア：
EMC対策により、機器の電磁環境
適合に貢献